

证券代码: 688323

证券简称: 瑞华泰

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 机构投资者调研活动汇总表

编号: 2022-01

	☑特定对象调研	口分析师会议
投资者活动 类别	口媒体采访	口业绩说明会
	口新闻发布会	口路演活动
	☑现场参观 □	口其他
参与单位	国海证券、广发基金、鹏华基金、翎展投资、中泓汇富、方瑞天成投资、慧	
名称	和资管	
时间	2022年5月12日、5月13日、5月19日、5月20日	
地点	公司会议室	
上市公司接 待人姓名	柳南舟、吴臻	
	1、公司目前有多少条产线?	
	答:公司目前投产	产的有9条产线,另有一条光学级产线正在安装。
	2、公司的产能有多少?利用率如何?产销量是否饱和?	
投资者关系活动主要介	答:公司的产能利	J用率受产品种类切换、设备检修等因素的影响, 生产
	线重新开机后,需一定时间达到满产运转。2021年度,公司产能约1050吨,	
	产能利用率为84%。产	销量基本平衡。
绍内容		
	3、为何 2021 年 PI 产	品库存增加?
	答: PI 产品库存量	量增加主要是由于 2020 年出货量高于生产量, 2020 年
	底库存量较低,2021年库存量恢复到正常水平。2021年,公司高性能 PI 薄	
	膜产销率为93%,产品销售情况良好。	
	4、为什么会销售产线?	



答:公司主营业务为高性能 PI 薄膜的研发、生产和销售,销售生产线为公司偶发业务,公司未将该项业务作为长期业务,该业务不会持续发生,不属于公司的主营业务。公司已将相关收益作为 2020 年度非经常性损益列示。

5、技术来源?

答:公司技术起源于国家高技术产业化示范工程,十七年来通过自主研发,掌握了配方、工艺及装备等完整的高性能 PI 薄膜制备核心技术,成功开发了热控 PI 薄膜、电子 PI 薄膜、电工 PI 薄膜等系列产品,打破了杜邦等国外厂商对国内高性能 PI 薄膜行业的技术封锁与市场垄断。

6、 高性能 PI 薄膜制备核心技术的组成方面?

答:高性能 PI 薄膜制备核心技术包括配方设计、生产工艺及装备技术 三方面,配方设计技术先进性可通过产品种类丰富程度衡量,生产工艺技术 先进性的主要衡量指标包括成型工艺、厚度及其均匀性、连续收卷长度、生产自动化程度和控制精度等,装备技术先进性指标包括设备幅宽、运行速度等。

7、 热法和化学法各有哪些优劣势?

答: 热法和化学法各有千秋。从工艺角度,热法和化学法区别在于 PAA 树脂流涎前是否加入催化剂; 从生产效率角度,假定相同幅宽的产线,化学法生产效率更高; 从投资角度,化学法设备投资更大; 从产品质量角度,各有特点(美国 D 公司既有化学法线,也有热法线; 日本 U 公司的 PI 膜用热法生产); 从新产品开发角度,化学法需要催化剂的添加,产品配方涉及的变量更多,新产品的开发相对更复杂。公司已同时掌握化学法与热法工艺及设备技术。

8、 生产 PI 薄膜的材料有哪些? 是在国内采购的吗? 有些特殊单体是否受限国外?



答:主要原材料是二胺和二酐等,在国内采购;特殊单体目前国内和国外都有供应。随着柔性显示、集成电路等新领域的应用牵引,对特种 PI 需求提供了增长潜力,上游 PI 单体企业也提升了研发及量产动力,相信未来在产业链共同的努力下, PI 特殊单体能实现国产自主可控。

9、近几年原材料价格波动较大,公司如何保证供应的安全性?

答:原材料价格受国家环保政策、市场供求关系等的影响,公司已与主要原材料供应商建立良好的合作关系,拥有稳定的供应商体系,近期化工材料有一定上涨压力,对公司毛利率略有影响。若未来主要原材料的采购价格持续处于上涨趋势,而产品售价不能随之上涨,或将对公司的经营业绩产生不利影响。公司将及时动态关注原材料市场价格走势并进行分析研判,适度调整采购策略,降低原材料价格波动对经营业绩造成的影响。目前从一季度来看原材料价格依然处于历史高位,但开始出现拐点趋势,后续我们也将及时动态关注。

10、 设备的采购渠道?

答:公司具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力,突破了我国高性能 PI 薄膜产业化的技术瓶颈,根据自主开发的技术工艺要求,自行设计非标专用设备,进行国内外定制化采购,实现了主要设备使用和运行的自主可控性。

11、 公司新增产能市场是否能有效释放?

答:随着 PI 薄膜行业技术进步,产品持续向高性能化方向发展,下游应用领域不断拓展,市场规模扩大;该行业目前主要被杜邦等少数国际厂商占据,国产化替代的前景良好,国内公司在 PI 薄膜行业的投入有助于推动国产化进程。作为国内高性能 PI 薄膜产业化的先行者,公司技术实力居于国内领先水平,获得了众多知名客户或终端品牌的认可,现有产能利用充分,需要扩大产能及升级装备、工艺以增强国际竞争力,新增产能的消化具备良好基础。



12、 嘉兴项目拟生产产品与现有产品的区别?

答:嘉兴瑞华泰高性能聚酰亚胺薄膜项目主要产品包括热控 PI 薄膜、电子 PI 薄膜、电工 PI 薄膜、特种功能 PI 薄膜等系列产品,系在现有产品基础上进行的产能扩展以及新品种开拓,并对现有产品系列进行规格和性能升级,进而实现产品结构升级。

13、 公司嘉兴项目人员储备如何?

答:公司通过内部培养和外部合作相结合的方式,近几年一直在进行人员队伍储备和培养,提升专业素质和能力,打造出一支专业素质过硬、人才梯度分布合理的技术研发团队,专业范围覆盖物理、化工、应用化学、材料学、化工机械、自动化等多个领域,公司后续技术发展具备充足的人才基础。同时,公司建立人才交流机制,畅通深圳和嘉兴两地的人才交流学习,实现人才队伍和相关经验在两地的互联互通,为募投项目的实施建立充足的人员储备。

14、 公司 CPI 产线进度如何?

答:公司 CPI 产线目前完成第一阶段设备调试,开始进入工艺调试阶段, 计划年中完成调试。

15、 生产 CPI 薄膜的技术是公司与下游共同研发的吗?目前还有哪些竞争 对手有 CPI 产线?

答:公司自主掌握 CPI 薄膜制备的核心技术,基于现有生产线生产出 CPI 薄膜,关键性能通过国内终端品牌厂商的评测,已实现样品销售,同时公司与终端对 CPI 专项产品开展了共同研发。CPI 薄膜目前商业化的主要为 韩国 K 公司,目前韩国 S 公司产线已完成建设开始拓展市场。

16、 目前哪些消费电子产品中有应用 CPI 薄膜? CPI 薄膜目前商业化存在哪些不足? CPI 薄膜与 UTG 玻璃各有哪些优劣势?



答:目前市场上已推出的多款折叠屏设备 Huawei Mate X、Moto Razr、Huawei Mate Xs、Moto Razr 5G、Thinkpad X1 Fold、Huawei Mate X2、Xiaomi MiX Fold、Huawei P50、荣耀 magic V、Huawei Mate Xs2等折叠屏产品均使用 CPI 薄膜材料。

当前折叠屏盖板用 CPI 薄膜商业供应依赖进口,产业链条复杂,主要包括 CPI 薄膜、硬化涂布、激光切割、BM 印刷、OCA 贴合、模组贴合设备组装、折叠设备等;需要进行多国家多地域流转,行业期待本土产业链能解决。

折叠盖板用 CPI 薄膜的特点主要包括:

安全性: 无碎裂风险, 适应水滴, 大屏与卷曲;

易加工性: 卷对卷加工, 加工产业成熟;

成本可降性:成本下降空间相对更大;

产品发展性:产品迭代速度快,可实现功能化叠加。

对于材料来说没有十全十美,两种材料均有优缺点,在折叠屏的盖板材料的选择目前主要是采用 CPI 薄膜与超薄 UTG 玻璃,其中折叠大屏、外折屏与卷轴屏几乎都采用了 CPI 薄膜的解决方案。

未来两种材料在性能均衡上均有提升空间。

17、 PI 浆料和 PI 薄膜有什么不同?

答: PI 浆料与 PI 薄膜是 PI 产品的两种形态,也是目前体量最大的两个市场。

18、 PI 未来有哪些新领域的应用?

答: 公司看好 PI 材料未来新兴领域的应用发展

1、高速通讯与智能化柔性电子基材应用领域

智能化与高速通讯的技术融合,感知和智能产品应用需求,陆海空天全 覆盖高速通讯系统建立,公司将努力探索基于高频高速传输线路基材、多规 格厚度柔性线路基材、高导热高导通基材、薄膜传感基材、柔性功能应用的 新产品研发和新市场拓展。

2、 柔性显示应用领域



柔性显示为 CPI 薄膜带来新的机遇。在柔性显示领域已有多家、多款产品开启了 CPI 应用,基于 CPI 产品特性具有卷对卷规模生产、应用设计可实现多元结构、具有生产和使用安全性等特点,随着显示器应用技术的发展,未来有着巨大的市场成长机遇,公司将继续深耕柔性显示应用 PI 材料领域,在光学级生产技术平台上开展系列化 CPI 光学级产品开发,目标为客户提供一站式 PI 材料解决方案,发展柔性 OLED 盖板模组、OLED 基板 CPI 浆料、显示器封装 PI 浆料等产品。

3、集成电路封装应用领域

加快响应国家"十四五"规划,围绕第三代半导体,集成电路封装、半导体器件等多个推动国产化的细分领域 PI 材料应用的产品开发,充分利用公司预研和储备技术,推动 COF 用 PI 薄膜、半导体 PI 胶带、半导体制成 PI 耗材等国产化产品进入市场。

4、清洁能源关键材料应用领域

公司计划开展新能源关键材料应用领域的技术和产品开发,目前在风力发电已有 PI 薄膜产品应用,在新能源汽车动力电机、高容量电池模组结构 开展 PI 薄膜应用技术拓展,公司计划建立清洁能源关键材料实验室,聚焦新能源汽车电池 PI 材料应用、新能源汽车动力电机 PI 材料应用、风能发电机 PI 应用和薄膜光电 PI 材料应用的产品系列研究。

19、 电子 PI 薄膜应用在哪些领域?客户群体有哪些?

答:电子 PI 薄膜主要包含两类:电子基材用 PI 薄膜和电子印刷用 PI 薄膜。电子基材用 PI 薄膜主要用于 FPC 的制备,最终应用于消费电子、5G 通信、汽车电子等领域,尺寸稳定性是决定该产品竞争力的主要特性。电子基材用 PI 薄膜作为绝缘基膜与铜箔贴合构成 FCCL 的基板部分,也可作为覆盖膜贴覆于 FPC 表面,用于保护线路免受破坏与氧化。电子印刷用 PI 薄膜制作成的电子标签主要贴覆于 PCB 等产品的表面,对其进行序列化标识,追溯生产全过程,帮助识别缺陷,最终应用于消费电子、5G 通信、汽车电子等领域。该产品的关键特性为良好的粘结适应性。在电子 PI 薄膜领域,公司已进入艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生益科技、台虹科技、联茂等知



名厂商的供应体系。

20、 公司的产品和国外竞争对手相比,有哪些优劣势?

答:就产品性能而言,公司主要产品的关键性能指标与杜邦等国际先进企业相当;根据应用领域的不同,产品性能各有特色,公司产品性能满足下游知名客户的高品质要求,获得客户较多好评。

就产品应用领域而言,公司的高性能 PI 薄膜产品种类丰富,产品线覆盖热控、电子、电工等多个领域,此外还有实现小批量销售的航天航空 PI 产品,以及实现样品销售的柔性显示用 CPI 薄膜。同行业竞争对手中杜邦的产品种类齐全,钟渊化学等多在其各自领域有所侧重。

目前的产能规模不足是公司产品的主要竞争劣势。同行业主要竞争对手 杜邦、钟渊化学、PIAM等的年产能多在 2,000 吨以上,可有效满足知名大 客户群体的订单需求;相比之下,公司的产能规模存在差距,虽然多种产品 可替代进口产品,但供应能力受限于产能,与下游大客户的合作金额具有较 大的成长空间。公司将加快产能建设,拓宽 PI 薄膜的新应用领域及高端市 场,增强市场竞争力。